

[407 A] GERFLOR ACOUSTIC 15 DB

Niniejsze Wytyczne montażowe są powiązane z dokumentem [407] WYTYCZNE MONTAŻOWE: SYSTEM CREATION CLIC 55 I 70 oraz VIRTUO 55 CLIC



DEFINICJA: Podkład poliestrowy bez włókniny o grubości 0,93 mm w kolorze białym przechodzącym w jasnozielony

- ❶ Włókno lub filc = Od strony podłoża
- ❷ Połyskliwa powierzchnia antypoślizgowa = Od strony produktu Clic

1. ZASTOSOWANIE

Do wszystkich zastosowań w budynkach mieszkalnych i komercyjnych (pomieszczeń o niskim, średnim i wysokim natężeniu ruchu, wg CEN 23-31, 33-42 i 34-43).

Nie stosować maszyn (wózków, paleciaków, wózków widłowych itp.) na PRODUKTACH Gerflor CLIC położonych na podkładzie Gerflor Acoustic 15 dB.

■ 1.1. WARUNKI ZASTOSOWANIA PRODUKTÓW GERFLOR CLIC Z PODKŁADEM.

Podkład nadaje się do zastosowania z produktami GERFLOR CLIC (SYSTEM CREATION 55 CLIC, SYSTEM CREATION 70 CLIC i VIRTUO 55 CLIC) w pomieszczeniach klimatyzowanych, gdzie temperatura mieści się w zakresie od 15 do 25°C. Dopuszczalny zakres temperatur po montażu: od +10° do +30°C. Zaleca się montaż systemu regulacji temperatury (klimatyzatora) lub zabezpieczenie materiału przed bezpośrednim dostępem promieni słonecznych (zastony, żaluzje itp.). W przypadku temperatur powyżej lub poniżej tego zakresu zaleca się nałożenie kleju na całą powierzchnię. W przypadku powierzchni większych niż 150 m² należy rozdzielić klej między podkład na podłożu A panela/płytki na podkładzie (min. szerokość 50 cm). Nie kleić na obrzeżach pomieszczenia. Bez względu na powierzchnię nie zostawiać żadnego odcinka > 5 m bez kleju, nawet poza obszarami nieklejonymi. Więcej szczegółów znajduje się w pkt 2.2: Przytwierdzenie podkładu. Należy zastosować klej do podkładu przed wykuszami, pod świetlikami lub w miejscach naświetlonych oraz w strefach zawracania i pod krzesłami na kółkach.

PODŁOŻE/STREFY	OBSZARY DZIELONE, STREFY ZAWRACANIA I OBSZARY POD KRZESŁAMI NA KÓŁKACH		MIEJSCA NAŚWIETLONE, PRZED WYKUSZAMI LUB POD ŚWIETLIKAMI	
	PODKŁAD NA PODŁOŻU	SYSTEM CLIC NA PODKŁADZIE	PODKŁAD NA PODŁOŻU	SYSTEM CLIC NA PODKŁADZIE
Stare płytki	Dwustronna taśma samoprzylepna o dużej szerokości ⁽³⁾		Dwustronna taśma samoprzylepna o dużej szerokości ⁽³⁾	
Stara kompaktowa wykładzina winylowa	Klej akrylowy ⁽¹⁾ lub dwustronna taśma samoprzylepna ⁽³⁾	Klej akrylowy ⁽¹⁾ lub dwustronna taśma samoprzylepna o dużej szerokości ⁽³⁾	Klej odporny na wysokie temperatury ⁽²⁾ lub dwustronna taśma samoprzylepna o dużej szerokości ⁽³⁾	Klej odporny na wysokie temperatury ⁽²⁾ lub dwustronna taśma samoprzylepna o dużej szerokości ⁽³⁾
Podłoże drewniane: patrz definicja w Wytycznych montażowych 407 dla Systemu Creation Clic 55 i 70 oraz Virtuo Clic. Rozdział 1: Zastosowanie.				
Podłoże mineralne, bez przenikania wilgoci	Klej akrylowy ⁽¹⁾ lub dwustronna taśma samoprzylepna ⁽⁴⁾	Klej akrylowy ⁽¹⁾ lub dwustronna taśma samoprzylepna o dużej szerokości ⁽³⁾	Klej odporny na wysokie temperatury ⁽²⁾ lub dwustronna taśma samoprzylepna o dużej szerokości ⁽⁴⁾	Klej odporny na wysokie temperatury ⁽²⁾ lub dwustronna taśma samoprzylepna o dużej szerokości ⁽⁴⁾

(1) Wykładzinę układa się za jednym razem z użyciem kleju wodorozcieńczalnego, szpachelką z małymi zębami (typ A2 w standardzie TKB). Wydajność krycia: ok. 300/350 g/m². Jak najczęściej zmieniać szpachelkę w celu zachowania pokrycia na ww. poziomie.

(2) Wykładzinę układa się za jednym razem z użyciem kleju odpornego na wysokie temperatury, szpachelką z małymi zębami (typ A2 w standardzie TKB).

Wydajność krycia: ok. 300/350 g/m². Jak najczęściej zmieniać szpachelkę w celu zachowania pokrycia na ww. poziomie. Np. POWER ELASTIC marki BOSTIK.

(3) DUOLAY marki D-TACK, w sprzedaży u Gerflor, nr ref.: 06410001.

(4) EXTRA-LAY marki D-TACK + D-TACK REMOVE PRIMER, brak u Gerflor.

[407 A] GERFLOR ACOUSTIC 15 DB

■ 1.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podkład Gerflor Acoustic 15 db można kłaść na podłożu wymienionym poniżej i w następujących warunkach szczegółowych.

1.2.1. Wymagania dotyczące NOWYCH lub ODNAWIANYCH podłoży

Posadzkę należy kłaść na płaskim, czystym, suchym i mocnym podłożu.

Tolerancja płaskości posadzki musi być mniejsza niż 5 mm przy pomiarach liniałem 2 m (3 mm liniałem 2 m w przypadku wylewek anhydrytowych i cementowych); nie dopuszcza się nierówności.

A) POWIERZCHNIA Z IZOLACJĄ PRZECIWWODNĄ:

Zawartość wilgoci musi być niższa od 4,5% w przypadku płyty betonowej ze skuteczną barierą paroizolacyjną lub 0,5% w przypadku wylewek anhydrytowych i cementowych CCM (Control Carbide Moisture). Zgodnie z normą ASTM F2170-11 przyjmuje się 3 lb (ok. 1,5 kg) / 75% RH dla płyty betonowej i anhydrytu ze strukturalną membraną przeciwwilgociową.

B) PŁYTKI:

Podłoże nie może mieć nierówności, a łączenia nie mogą być cofnięte i większe niż 4 mm. W przeciwnym razie należy wypełnić je fugą.

C) PODŁOŻE DREWNIANE:

Patrz tabela w wytycznych montażowych dla SYSTEMU CREATION 55 CLIC, SYSTEMU CREATION 70 CLIC lub VIRTUO 55 CLIC, Rozdział

1: Zastosowanie.

D) PŁYTKI WINYLOWE I ROLKI KOMPAKTOWE:

Jeżeli wymagania dotyczące podłoża zostały spełnione i ponad 90% powierzchni pomieszczenia jest w dobrym stanie, należy usunąć wadliwe płytki i wypełnić luki wylewką. W przeciwnym razie konieczne będzie usunięcie całej posadzki i przygotowanie podłoża od podstaw.

E) SYSTEMY OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO:

Ogrzewanie podłogowe z obiegiem gorącej wody DO 28°C: możliwe. Zaleca się klejenie w celu utrzymania wszystkich właściwości termicznych systemu ogrzewania podłogowego.

Promiennikowe elektryczne ogrzewanie podłogowe: regulacje wymagają $\leq 0,15 \text{ m}^2 \times \text{°K/W}$: klejenie obowiązkowe.

Niskotemperaturowe odwracalne wodne ogrzewanie podłogowe: możliwe. Zaleca się klejenie w celu utrzymania wszystkich właściwości termicznych systemu ogrzewania podłogowego.

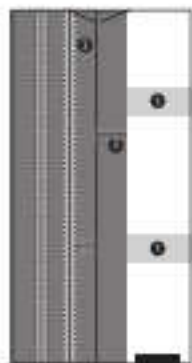
2. MONTAŻ PODKŁADU

2.1. UKŁADANIE NA PŁASKO

- Rolki należy przechowywać w miejscu, gdzie nastąpi ich montaż, przez co najmniej 24 godziny przed montażem (min. temperatura otoczenia 20°C).
- Temperatura w pomieszczeniu podczas montażu musi wynosić od 15 do 25°C.
- Rozwijać podkład z włóknem lub filcem skierowanym do dołu, w tym samym kierunku, w jakim układane są deski.
- Rozwijać podkład w kierunku ściany z największym oknem albo wzdłuż pomieszczenia.
- Układać podkład krawędź do krawędzi.
- Ciąć podkład wzdłuż ścian lub istniejących listew cokołowych.

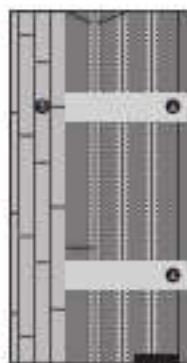
■ 2.2. PRZYTWIERDZANIE PODKŁADU

2.2.1. Położenie podkładu



- 1 Podzielić pomieszczenie w taki sposób, aby nie było powierzchni dłuższych niż 5 m bez kleju. Nałożyć klej na minimalną szerokość 50 cm. Delikatnie ciągnąć za podkład rękoma podczas montażu produktów Gerflor Clic, aby zapobiec powstawaniu fałdów pod płytkami lub deskami. Metoda pozwala zapobiec przemieszczaniu się desek.
- 2 Nałożyć klej pod połączenia end-to-end
- 3 Taśma klejąca: Skleić górę rolek podkładu jednostronną taśmą klejącą (minimalna szerokość: 75 mm)

2.2.2. Montaż produktów Gerflor Clic na podkładzie:



- 4 Nałożyć klej na podkład powyżej sklejonego obszaru.
- 5 Zamontować produkty Gerflor Clic (patrz Wytyczne montażowe 407 dla Systemu Creation Clic 55 i 70 oraz Virtuo Clic 55)



Płytki lub panele najlepiej kłaść w tym samym kierunku, co podkład. Upewnić się, że połączenia płytek/desk nie pokrywają się z połączeniami podkładowymi.